

TIG[®]7835N 是一种以液态金属为载体、填充高热粉体的导热膏，可以有效降低散热器及发热源之间的接触热阻。适用于需要较小压缩厚度、恒定压力和易于丝网印刷以获得最佳性能的应用场合。可用于需要避免流动性的场景，如垂直摆放芯片、随时移动或有震动可能的使用环境等。本产品经振动测试，可明显减低传统液态金属易于流动的风险，但仍建议使用泡棉等围堵体以免在极端环境下外溢产生短路问题。



特性

- 》高导热系数、低热阻
- 》耐候性、可靠性佳
- 》低表面能，易施工
- 》高触变性，不流淌
- 》非易燃易爆、无毒环保

应用

- 》网络通讯装备-无线模块、路由器
- 》IT-笔记本、服务器、电脑、存储模组
- 》激光器与光学设备
- 》工业电源、LED照明、工控设备等
- 》消费类电子、游戏系统、便携设备

TIG[®]7835N 特性表

性能指标	数值	测试方法
颜色	银色	目视
结构&成份	镓基合金与导热粉	-
密度 (g/cm ³)	7.0	ASTM D792
最小界面厚度 (mm)	0.038	ASTM D374
电阻率 (Ω·m)	< 10 ⁻⁴	ASTM D257
黏度 (mPa·s)	400	GB/T 10247 (Brookfield #18; 10rpm)
比热容 J/(g·°C) @25°C	0.266	ASTM E1269
导热系数 (W/m·K)	35	ASTM D5470
建议使用温度范围 (°C)	-40~200	-
保质期 (月) (未开封)	12	-
RoHS标准	符合	-

使用说明

- 使用前应保证热源与散热器表面干燥且无任何残留物。
- 使用前应先室温下静置至少4小时并使用具备公转加自转功能的离心脱泡机进行搅拌混和与脱泡至少2分钟。
- 液态金属具有优异的导电性，应避免其与电路板等直接接触造成短路。
- 镓基液态金属易与部分金属，如铝发生反应，造成结构脆化，若需与铝接触，请先做好阳极处理，但敝司不保证其长期稳定性。
- 开封后请加盖保存在温度为30°C以下且相对湿度为60%RH以下的环境，否则将产生氧化水解反应，建议一周内使用完毕。

注意事项

- 切勿食用
- 避开儿童可触及的地方保管
- 请确定使用的正确性后再使用
- 去除时可使用普通湿巾或酒精湿巾擦拭

产品规格

1ml/支, 5ml/支, 30ml/支

如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网。

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

黏度

